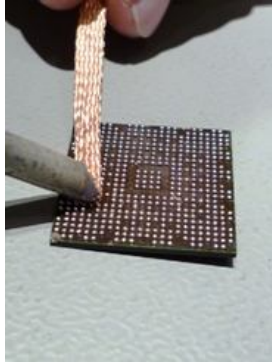


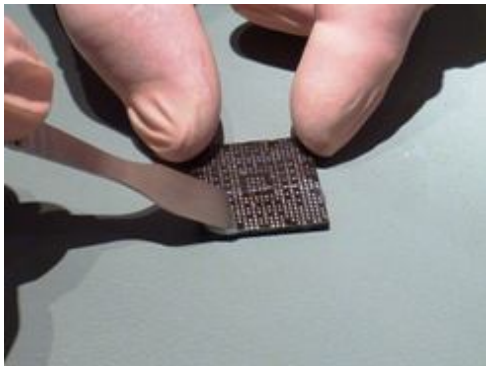
## PROCEDIMIENTO PARA UTILIZAR EL KIT DE REBALLING KREBALLBT-1



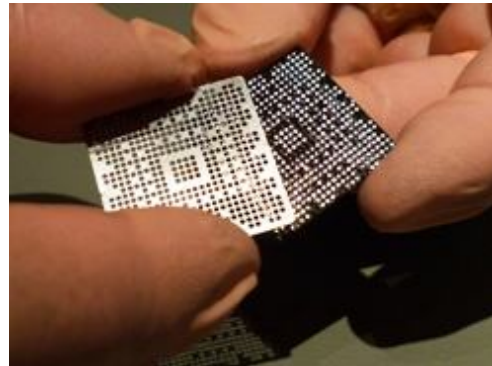
1.- Remover las bolas de soldadura del BGA utilizando malla desoldadora y cautín con punta plana en bisel. Recomendamos la Malla CHEMTRONICS, 2.2 mm.



2.- Remover los residuos de flux aplicando removedor de flux. Recomendamos el aerosol marca CRAMOLIN modelo FLUX OFF.



3.- Aplicar una fina película de flux crema utilizando la espátula incluida en el kit. Recomendamos el flux crema marca SANWA modelo SPF-176.



4.- Instalar el stencil específico para el BGA, centrándolo en cada una de las pistas.



5.- El flux crema dejará el stencil suficientemente adherido para la manipulación del BGA.



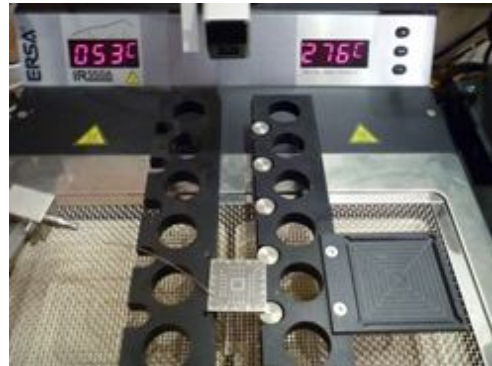
6.- Depositar el BGA sobre un plato de fondo plano y derramar las bolitas de soldadura sobre el stencil, recibiendo el plato las bolitas sobrantes.



Nota Importante: Utilice siempre elementos y herramientas Antiestáticas en la manipulación de componentes SMD.



7.- Distribuir las bolitas en cada perforación del stencil utilizando un bastoncito terminado en algodón o en fibra tipo esponja



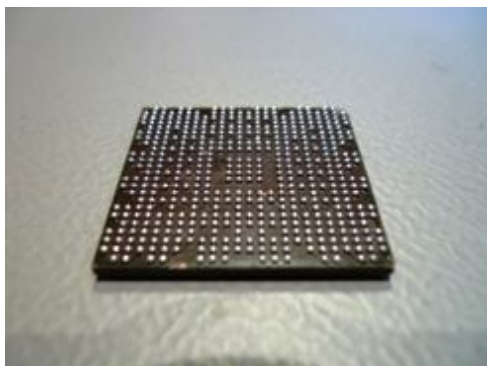
8.- Instalar el BGA con stencil y bolitas en la máquina de retrabajo. Aplicar un gradiente térmico hasta 10°C sobre la temperatura de fusión de las bolas y esperar que se enfríe el BGA.



9.- Desprender el stencil, introduciendo una hoja o cuchillo muy delgado entre stencil y el BGA, gradualmente, toque a toque, uniformemente en las 4 esquinas y en los 4 bordes, hasta desprender el stencil.



10.- Limpiar el flux remanente con removedor de flux.



11.- El BGA quedará limpio y con todas las bolas instaladas y soldadas.



12.- Retornar el sobrante de bolitas a su frasco.

LL/12.09



Nota Importante: Utilice siempre elementos y herramientas Antiestáticas en la manipulación de componentes SMD.